



Условное	Номинальный	Наличие	Количество
обозначение	диаметр	металлизации	отверстий
отверстий	отверстий,	в отверстиях	
	MM		
•	0,6	да	3
•	1,6	да	8

Условное	Ширина	Длинна	Количестви
обозначение	контактной	контактной	контактны
контактной	площадки,	площадки, мм	площадок
площадки	MM		
1	0,4±0,05	2,5±0,1	2
	1,45±0,05	2,6±0,1	5
	1,5±0,05	2,4±0,1	4

Технические требования:

- Плату изготовить комбинированным методом;
- 2. Шаг координатной сетки 2.5 мм;
- 3. Проводники выполнить шириной 0.5 мм,
- 4. Расстояние между проводниками не менее 0.2 мм;
- 5. Толщина проводящего слоя 0.3 мм,
- 6. Плату изготовить из фольгированного текстолита по ГОСТ 23762–73;

					Дипломный проект			
<i>Ра.</i> Пр	າ <u>ດ</u> ໍ່	Карандаев В.Ю. Рубцов В.И.	Подп.	Дата	Чертеж проводящих слоев	/lum.	Масса	<u>Масштаб</u> 4.1
	70HMP.				Плата стабилизации напряжения	Nucm MFTY Spunnu	<u>Листо</u> им. Н.Э. 1 7. СМ7–12	Бацмана



